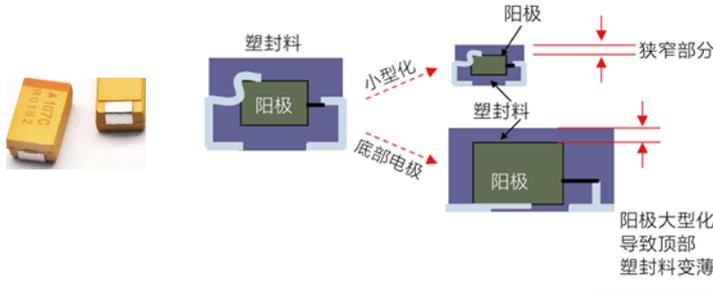
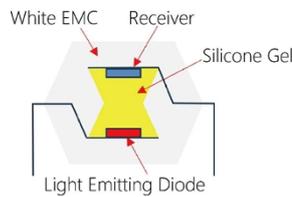


塑封料

主要產品



電容用
高可靠性塑封材料
Epoxy molding
compound



光電用塑封材料
高反光
Opto Coupler

一般特性

QFN DFN -白色塑封料 |

- 通可靠性
- 高耐黃變

參數	單位	MH-G2000-WH	MH-G2000-WH-J
填料比例	-	86%	87%
填料直徑	Um	75	75
流動長度	cm	190	210
凝膠時間	S	60	60
Tg	°C	170	145
CTE a1	PPM	13	12
CTE a2	PPM	40	40
吸水率	%	0.18	0.16
彈性模量	GPa	12	12
彈性強度	MPa	130	125
CL	PPM	30	30



電容用塑封材料

- 高韌性
- 高可靠性

參數	單位	MH-G2000-Y	MH-G280D
		黃色	黑色



參數	單位	MH-G2000-Y	MH-G280D
填料比例	-	86%	88%
填料直徑	μm	75	75
流動長度	cm	150	150
凝膠時間	s	40	40
Tg	°C	170	130
CTE a1	PPM	13	12
CTE a2	PPM	40	40
吸水率	%	0.19	0.16
彈性模量	GPa	11	13
彈性強度	MPa	125	110
CL	PPM	30	30

薄膜顆粒

參數	單位	WAX-100	WAX-100-7
特性	-	適用於 BGA, QFN 耐高溫焊, 提高 連續模數	適用於 高韌性 防粘模
填料比例	-	74%	79%
填料直徑	pm	75	105
WAX	-	WAX 2	WAX 3
流動長度	cm	240	200
凝膠時間	s	60	50
彈性模量	GPa	11	13
彈性強度	MPa	70	90